

2011年3月期 第2四半期 決算説明会

(2010年10月29日実施)

代表取締役社長 久芳 徹夫 スピーチ

<本日のプレゼンテーション>

本日は、2011年3月期第2四半期決算の概要及び2011年3月期業績予想についてご説明いたします。まず当期6ヵ月通算の決算概要について、ご説明申し上げます。

<P.1：2011年3月期 6ヵ月通算 決算概要（前年同期比）>

スライドの最下段にありますとおり、当期6ヵ月通算の平均為替レートは、米ドルは前年同期の95円から6円円高の89円、ユーロは前年同期の133円から19円円高の114円となりました。この円高により、前年同期に比べ、売上高に対し約320億円、税引前四半期純利益に対し約140億円のマイナスの影響がありました。

円高の影響はありましたが、好調な部品需要と機器事業で積極的な新製品投入を図ったことにより、売上高は前年同期に比べ30%を超える増収の6,374億円となりました。特に利益は、原価低減や生産性の向上をはじめとした各事業での収益性向上に向けた取組みの成果が生産の拡大に伴い大きく現れたことにより、営業利益、税引前四半期純利益、四半期純利益のいずれも前年同期に比べ大幅に増加し、収益性も大きく改善しました。

また設備投資額は、半導体部品関連事業やソーラーエネルギー事業などでの増産投資を実施したことにより、前年同期比で約2.4倍となりました。

<P.2：2011年3月期 6ヵ月通算 事業セグメント別売上高>

事業セグメント別の売上高を資料の2ページに記載しております。部品事業の売上高は、前年同期比40.4%増加の3,440億円、機器事業の売上高は25.3%増加の2,393億円となりました。

<P.3：2011年3月期 6ヵ月通算 事業セグメント別事業利益>

3ページには事業セグメント別の利益を示していますが、部品事業の利益は前年同期比561億円増加の617億円、機器事業は154億円増加の163億円とそれぞれ大幅な増加となりました。また、事業利益は約10倍の826億円となりました。

<P.4：2011年3月期 6ヵ月通算 決算要約（前年同期比）>

こちらのスライドには、当期6ヵ月通算の決算要約を記載しております。前年同期に比べ円高の影響はあったものの、当期6ヵ月は全てのセグメントにおいて増収増益を達成しました。

まず部品事業ですが、良好な事業環境と生産能力の増強により、収益拡大を図ることができました。特にデジタルコンシューマ機器や産業機械、自動車の各市場での部品需要が増加し、国内外での補助政策の牽引により、太陽光発電システムの需要も拡大しました。

また、このような旺盛な需要に対応するため、デジタルコンシューマ機器向けのセラミックパッケージや太陽電池の増産体制の確立を進めたことも部品事業の拡大に貢献しました。

この結果、当期6ヵ月通算の部品事業の利益率は17.9%へ大きく改善させることができました。

次に機器事業では、通信機器関連事業の大幅な収益改善を図ることができました。国内外で積極的に携帯電話端末の新製品を投入し、ラインナップを拡充させ売上拡大に結びつけることができました。

こうした売上高の増加に加え、前期に進めた事業構造改革の効果が特に海外での携帯電話端末事業の収益性改善に現れた結果、通信機器関連事業の事業利益は前年同期の75億円の損失から19億円の黒字へと、94億円の改善となりました。

<P. 5 : 半期別業績推移>

こちらのグラフは半期別の売上高及び税引前利益の推移です。

当期上期の売上高は、金融危機以前の2009年3月期上期の売上高には届かないものの、税引前利益は同時期を上回り、税引前利益率は14.0%まで改善しました。

以上が当期6ヵ月通算の業績に関する説明です。

<P. 6 : 2011年3月期 第2四半期(3ヵ月) 決算概要(第1四半期比)>

次に当期第1四半期と比較して説明いたします。当期第2四半期は第1四半期に比べさらに円高が進んだものの、部品事業で着実に売上高を伸ばすことができ、これに伴い営業利益も増加しました。一方、税引前四半期純利益は、第1四半期にありました約40億円の受取配当金の減少が影響し減益となっていますが、この受取配当金を除くと増益となります。

また四半期純利益については、海外子会社での業績改善に伴い、繰延税金資産を計上したことにより、増益となりました。最後に表の下段に記載しております円高の影響についてですが、第1四半期に比較し、ドル、ユーロともにそれぞれ6円の円高となったことにより、売上高に対し約110億円、税引前四半期純利益に対し約35億円のマイナスの影響がありました。

<P. 7 : 2011年3月期 第2四半期(3ヵ月) 事業セグメント別売上高(第1四半期比)>

<P. 8 : 2011年3月期 第2四半期(3ヵ月) 事業セグメント別事業利益(第1四半期比)>

セグメント別の状況ですが、7ページと8ページにそれぞれ売上高と事業利益を第1四半期と比較して記載しています。部品事業は第1四半期と比較しても増収増益となりましたが、機器事業は通信機器関連事業の収益減により、第1四半期に比べ減収減益となりました。

第1四半期と比較した要約について、次の9ページで説明させていただきます。

<P. 9 : 2011年3月期 第2四半期（3ヵ月）決算要約（第1四半期比）>

まず部品事業については、第1四半期に引き続き需要が高水準で推移したことにより、増収増益となりました。デジタルコンシューマ機器や産業機械、自動車市場向けの部品の売上が増加しました。また、ソーラーエネルギー事業の売上も国内外での需要拡大により増加しました。増収による効果と生産性向上により、第2四半期は全ての部品事業セグメントで15%を超える事業利益率を達成することができました。

要約の2つ目は通信機器関連事業の収益減少です。第2四半期は新製品投入の端境期となり、旧モデルの販売が中心となったことに加え、円高の影響もあり、第1四半期に比べ収益が減少しました。

さらに、10月14日に提出されたウィルコム社の更生計画案の内容を踏まえて、第2四半期にウィルコム社向け債権について約7億円の貸倒損失の追加計上を行ったことも、利益を押し下げる要因となりました。

以上が第2四半期3ヵ月の実績に関する説明であります。

それでは続きまして、通期の業績予想についてご説明申し上げます。

<P. 10 : 2011年3月期 業績予想>

当期6ヵ月の実績と第3四半期以降の需要見通しを踏まえて、本年4月に公表しました通期業績予想をこちらの表に記載のとおり修正しました。売上高及び利益ともに、前回予想から大幅に上方修正しております。売上高は前回予想比600億円増額の1兆2,600億円、税引前利益は280億円増加の1,600億円を予想しています。

下期も円高基調が続くものと予想しており、通期の平均為替レート的前提はドルは85円、ユーロは112円へと修正しました。

為替レートの変動により、売上高及び税引前利益は前期に比べそれぞれ約800億円、約300億円、押し下げられることとなります。

事業セグメント別の業績予想につきましても、11ページ、12ページに記載しておりますとおり修正しました。

<P. 11 : 2011年3月期 事業セグメント別売上高予想>

11ページに記載の事業セグメント別売上高については、情報機器関連事業セグメントのみ下方修正しました。

<P. 12 : 2011年3月期 事業セグメント別事業利益予想>

12ページの事業セグメント別利益については、前回予想を下回るセグメントはなく、ほとんどのセグメントで利益を上方修正しました。

業績予想の修正要因については、次の13ページで説明させていただきます。

<P.13：2011年3月期 通期業績予想の修正要因>

修正要因の1つ目は、部品事業の環境が期初予想に比べ良好であることです。スマートフォンなどの高機能なデジタルコンシューマ機器の需要増加や、産業機械、自動車市場での生産も想定以上に回復しています。この結果、部品事業は前回予想に対し売上高で420億円、事業利益で215億円上回る見通しです。

2つ目は、機器事業における通信機器関連事業での販売増加です。特に、上期の携帯電話端末の販売が好調であったことにより、機器事業の売上高は前回予想に比べ210億円上回る見通しです。

また事業利益については、情報機器関連事業の収益性改善により、前回予想を24億円上回る見通しです。

続きまして、この通期業績予想を達成するための下期の取組みについて事業セグメント別にご説明いたします。

<P.14：事業セグメント別下期の取組み ファインセラミック部品関連事業>

まず、ファインセラミック部品関連事業ですが、デジタルコンシューマ機器向けの部品需要は、下期は弱含みで推移するものと予想しております。

一方、自動車関連部品においては、欧州での環境対応エンジン向けの需要が下期はさらに増加するものと予想しております。

当セグメントにおいては、下期も半導体製造装置用部品やピエゾ素子、グロープラグなどの環境対応エンジン向け部品の拡販を進めるとともに、各事業の生産性向上により、収益性改善に努めてまいります。

左側のグラフに示しますとおり、円高の影響もあり、下期の売上高は上期を若干下回りますが、事業利益については上期を上回る見通しであります。

<P.15：事業セグメント別下期の取組み 半導体部品関連事業>

続いて半導体部品関連事業ですが、スマートフォンなどの高機能デジタルコンシューマ機器の需要は下期も堅調に推移すると予想しておりますが、サーバー関連市場については、一部の客先において生産調整を見込んでおります。

このような市場見通しのもと、下期の売上高、事業利益は円高の影響もあり、上期を下回ると予想しております。

下期の取組みとしては、水晶/S AWデバイス用を中心とした携帯電話端末向けのセラミックパッケージの拡販と生産能力の拡大により、売上増に努めてまいります。また、有機パッケージについてはサーバー関連の生産調整は一時的なものと考えており、引き続き、ASIC用の有機パッケージの拡販に取

組んでまいります。

<P. 16 : 事業セグメント別下期の取組み ファインセラミック応用品関連事業>

次のファインセラミック応用品関連事業につきましては、ソーラーエネルギー事業では住宅用、産業用ともに国内外での需要が拡大する見通しです。一方で、製品価格の下落が見込まれます。

このような市場見通しのもと、このセグメントの下期の売上高は上期に比べ増加するものの、事業利益は円高の影響も加わり、上期を下回る見通しです。

下期の取組みとしては、今期600MWのセル生産の達成に向けて、引き続き、生産能力を増強してまいります。さらに下期中には中国/天津でのモジュール新工場棟が完成する予定であります。

引き続き、太陽電池の高効率化や生産性の向上に取り組んでまいります。

<P. 17 : 事業セグメント別下期の取組み 電子デバイス関連事業>

続いて電子デバイス関連事業ですが、スマートフォンの需要は下期も堅調に推移するものの、従来の携帯電話端末やPC、薄型TVの生産調整が予想されます。

左側のグラフに示しますように、下期の当セグメントの売上高及び事業利益は円高の影響もあり、上期に比べ減少する見通しです。

下期は、スマートフォン向けの小型・高容量コンデンサやTCXOの拡販に注力するとともに、中国市場の開拓を進めてまいります。

<P. 18 : 事業セグメント別下期の取組み 通信機器関連事業>

通信機器関連事業については、米国ではスマートフォンの需要拡大が見込まれるものの、国内の携帯電話端末の需要は鈍化が予想されます。しかし、国内においては、下期はウィルコム再建によるPHS端末の需要の回復も期待されます。

米国市場については、第2四半期に発売しましたタッチパネルタイプのスマートフォン“Zio”の販売が好調に推移しており、下期は複数キャリアへの展開を予定しております。

国内市場に対しては厳しい環境が予想されるものの、上期同様、CDMA1x端末からWIN端末への買い替え需要の獲得に向けて、新製品の拡販を進めてまいります。

また、PHS関連事業については、新たなスポンサーのもとでの事業展開に即した製品展開を図ってまいります。

左側のグラフに示しますとおり、下期は、国内市場での販売減を主因に上期に比べ減収を予想しておりますが、事業利益は新製品投入の効果により、上期に比べ増加する見通しです。

<P. 19 : 事業セグメント別下期の取組み 情報機器関連事業>

情報機器関連事業につきましては、先進国での情報化投資の緩やかな回復に加え、新興国でのMFP及

び低価格プリンターの需要増加を見込んでいます。

下期の取組みとしては、先進国向けに、中・高速機やカラー機をはじめとする付加価値の高いデジタル複合機を中心にラインナップを拡充する計画であり、下期は上期を上回る新モデルの投入を図ってまいります。

特に、新興国市場に対しては、A4・MFP及び低価格帯プリンターの販売を拡大させ、売上増につなげてまいります。

これにより、下期の売上高は上期に比べ増加するものと見込んでおります。しかし、事業利益については、価格低下や円高の影響により、上期に比べ減少するものと予想しております。

<P. 20：事業セグメント別下期の取組み その他の事業>

最後に、その他の事業ですが、下期は上期に比べ増収減益となる見通しです。

京セラコミュニケーションシステムにおいて、ICT事業の需要は増加が見込まれる一方で、価格競争の激化が予想されます。

さらに、通信エンジニアリング事業においても厳しい競争が予想されます。

下期はICT事業の売上拡大を図るとともに、ウィルコムによる基地局関連投資での事業機会の獲得に努めてまいります。

<P. 21：2011年3月期 通期業績予想の達成>

ただ今申しあげました各事業での取組みを進め、今期の業績予想である売上高1兆2,600億円、税引前利益1,600億円の達成に努めてまいります。

このグラフのとおり、今期は円高により収益面で大きな影響はあったものの、金融危機以前の2007年3月期の業績水準まで回復させることができる見通しです。

今後のグループ業績の向上を図るために、さらなる売上拡大を目指してまいります。

以 上